BODACC

BULLETIN OFFICIEL DES
ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES
ANNEXÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'information légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE
26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
www.dila.premier-ministre.gouv.fr
www.bodacc.fr
-

BODACC « A »

Annonce n° 849

75 – PARIS

GREFFE DU TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Ventes et cessions

938 452 729 RCS Paris.
EKC ELECTRONICS FRANCE SAS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 10000.00 EUR.
Adresse : 58-60, avenue de la Grande Armée, 75017 Paris.
Précédent propriétaire : 821 916 400 RCS Paris. **DSP.**
Oppositions : Article L.236-26 du code de commerce.
Commentaires : Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : DSP Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 22 rue Brunel 75017 Paris Capital : 46045000.00 EUR Numéro unique d'identification : 821916400 Lieu d'immatriculation : Paris. Société bénéficiaire de la scission : EKC Electronics France SAS Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 58-60 avenue de la Grande Armée 75017 Paris Capital : 10000.00 EUR Numéro unique d'identification : 938452729 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société bénéficiaire est prévue : actif de 22157375.09 EUR - passif de 6443805.09 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : Opération objet de la présente publication : scission partielle consistant en (i) un apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions, conformément à l'article L. 236-27 du Code de commerce, consenti par DSP au profit de EKC Electronics France de son activité Electronics (l'"Apport") consistant en la commercialisation de matériaux électroniques appartenant aux segments d'activité suivants du groupe DuPont : Technologies Semiconducteur (Semiconductor Technologies) (incluant les lignes d'activité Technologie de polissage chimico-mécanique (Chemical Mechanical Planarization Technologies (CMPT)), Lithographie (Litography), Boues de polissage chimico-mécanique (Chemical Mechanical Planarization (CMP) Slurries), Ecrans HDM/PI (Displays HDM/PI), Diodes électroluminescentes organiques (Organic Light Emitting Diodes (OLED)), Matériaux d'affichage (Display Materials), Technologies propres avancées (Advanced Clean Technologies) et Kalrez®), et Solutions d'interconnexion (Interconnect Solutions) (incluant, les silicones LED (LED Silicones), Métallisation et imagerie (Metalization and Imaging), Conditionnements avancés (Advanced Packaging (APT)), Silicones de semi-conditionnement (Semi Packaging Silicones), Stratifiés (Laminates), Films (Films), Matériaux de performance Laird (Laird Performance Materials) et Polymères électroniques (Electronic Polymers) (l' "Activité Apportée") et (ii) une attribution directe à l'associé unique de DSP, FilmTec Water Netherlands, Holding B.V., de l'intégralité des actions nouvelles du bénéficiaire de l'Apport émises en rémunération de l'Apport conformément à l'article L. 236-27 alinéa 2 du Code de commerce (la "Scission Partielle"). Il est précisé que DSP continuera d'exister après la réalisation de la

Scission Partielle. La Scission Partielle sera réalisée et prendra effet le 1er octobre 2025 (la "Date de Réalisation"), sous réserve de la réalisation, à cette date, des conditions suspensives décrites à l'article 8 du traité de scission partielle. La Scission Partielle prendra effet, fiscalement et comptablement, à compter de la Date de Réalisation (sans rétroactivité). Le bénéficiaire de l'Apport sera propriétaire et prendra possession des biens et droits reçus dans le cadre de l'Apport à compter de la Date de Réalisation. Montant prévu de la prime d'Apport : L'Activité Apportée a été valorisée sur la base de sa valeur réelle conformément aux dispositions de l'article 743-1 du Plan Comptable Général. Cette valeur réelle a été arrêtée sur la base de la méthode décrite en annexe 6.3 (b) du traité de Scission Partielle. Dans la mesure où la Scission Partielle prendra effet à la Date de Réalisation, la désignation et l'évaluation des actifs apportés, des passifs apportés et, conséquemment, de l'actif net apporté, ont été arrêtés de façon provisoire et seront définitivement arrêtés sur la base d'un bilan comptable de l'Activité Apportée à la Date de Réalisation et établi postérieurement à celle-ci, ainsi que le prévoit l'article 7.3 du traité de Scission Partielle. La rémunération de l'Apport consisterait en l'émission par le bénéficiaire de l'Apport de 1.571.357 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées, par voie d'augmentation de capital, soit un montant total d'augmentation de capital de 15.713.570 euros. L'intégralité de ces actions nouvelles seront directement attribuées à l'associé unique de DSP qui se verra ainsi attribuer environ 3,4 actions ordinaires nouvelles du bénéficiaire de l'Apport pour chaque action de DSP qu'il détient. Aucune prime d'apport ne sera créée à l'occasion de l'Apport. . Date du projet commun de scission : 30.06.2025. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société DSP : 30.06.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société EKC Electronics France SAS : 30.06.2025 (au greffe du tribunal de commerce de Paris)..

